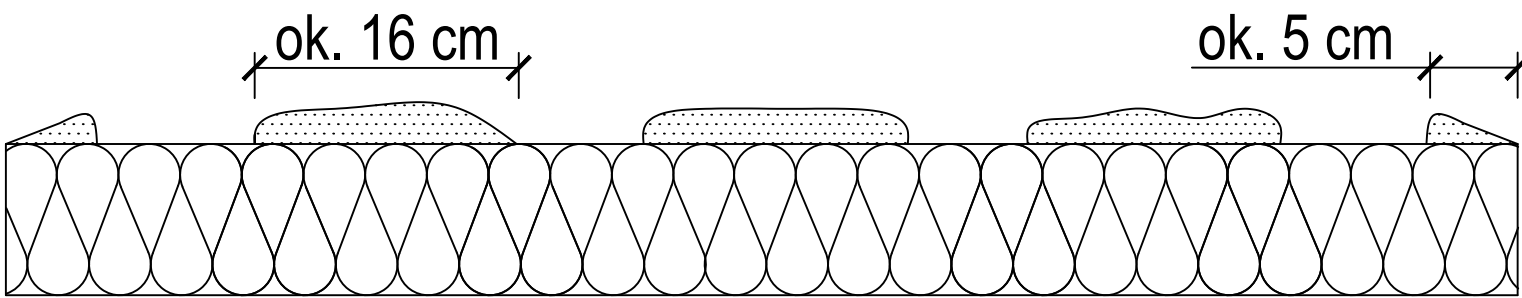


przekrój A - A



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwe i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Biuro Projektowe <b>MARBUD</b> Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data III 2019
	Nazwa rysunku	Sposób klejenia płyt izolacji termicznej	Skala 1:20
	Inwestor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Kochanowskiego 8, 78-550 Czaplinek	
	Adres inwestycji	ul. Kochanowskiego 8, 78-550 Czaplinek	Nr rys. 7
Opracował			Podpis
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 w specjalności konstrukcyjno budowlanej		Podpis